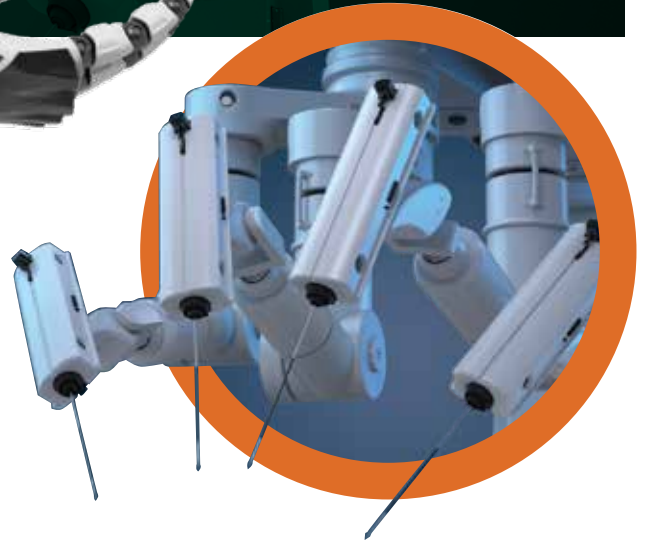


# Advancing Medical Technologies



## Optics

金スズ半田ワイヤや棒半田



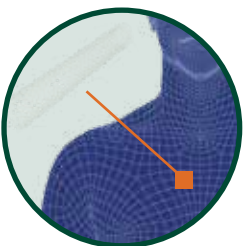
## Guide Wire

ニチノールやSUS接合用フラックス



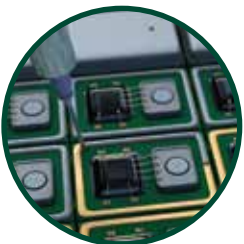
## Circuit Boards

半田ペースト



## Implantable Feedthroughs

金スズプリフォーム



## MEMS Sensors

ダイアタッチ用半田ペースト

Contact our engineers: [asiapac@indium.com](mailto:asiapac@indium.com)

Learn more: [www.indium.com/medical](http://www.indium.com/medical)

**From One Engineer To Another<sup>®</sup>**

©2020 Indium Corporation

Form No. 99708 (J A4) R0



# Advancing Medical Technologies

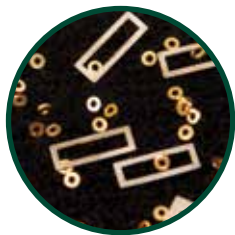


## Wearable Devices

- フレキシブル基板の組立
- MEMSのリッド封止
- 高機能デバイスの小型化

### PRODUCTS:

- 低温はんだ
- 超低残渣無洗浄フラックス
- ファインピッチ用半田ペースト、フラックス

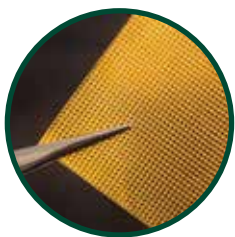


## Implantable Devices

- ハーメチックシール
- 高信頼性PCBアセンブリ
- ニチノールの接合

### PRODUCTS:

- 金系半田
- 低ボイド用フラックス
- 高活性フラックス



## Industrial Devices

- 極低温用シーリング
- 熱拡散
- RF接合

### PRODUCTS:

- インジウム系半田ワイヤやプリフォーム
- TIM材料
- 半田プリフォーム



Contact our engineers: [asiapac@indium.com](mailto:asiapac@indium.com)

Learn more: [www.indium.com/medical](http://www.indium.com/medical)

**From One Engineer To Another®**

©2020 Indium Corporation

Form No. 99708 (J A4) R0

